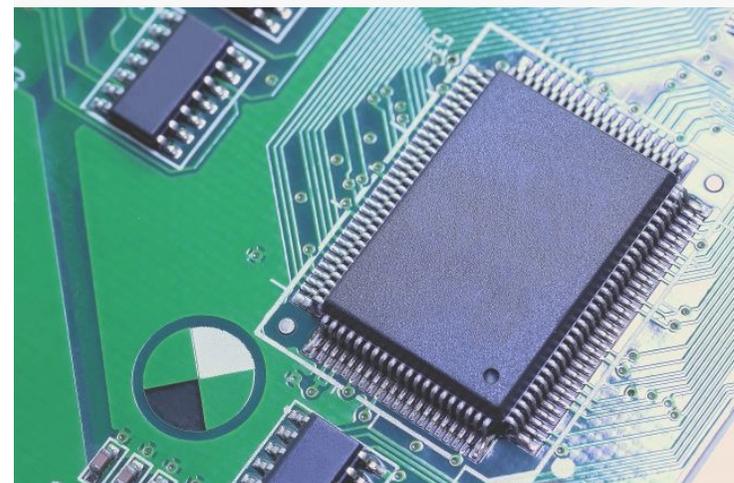




半導体ベンダーサーベイ 2024

● 申込締切：2024年 4月30日

2023/01/12 制作

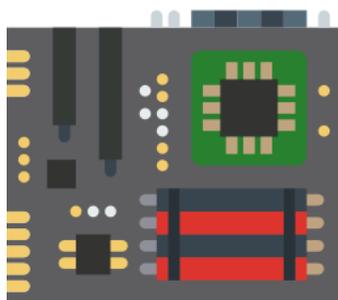


お問い合わせ アイティメディア株式会社 営業本部
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 13階
Mail : sales@ml.itmedia.co.jp

EE Times Japan / EDN Japan / MONOistでは毎年合同で、読者の皆様に向けて「半導体ベンダーサーベイ」という調査を実施しております。この調査は、読者の中から「**アナログ半導体**」「**デジタル半導体**」の購買に**関与する技術者**を抽出し、半導体ベンダーの製品認知度や企業評価についてアンケートを行う物です。

今回のベンダーサーベイは、3～4月の実施を予定しております。弊社では**2024年1月～4月に新規に広告をご出稿いただいたベンダー様**に、本サーベイのレポートをご提供いたします。

この機会に是非、広告のご出稿をご検討いただけますと幸いです。



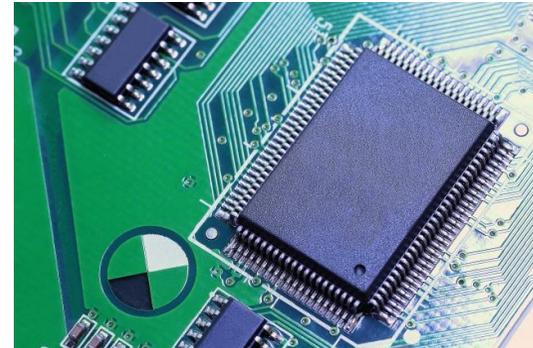
www.flaticon.com

※半導体ベンダーサーベイとは？

EDN Japanが毎年読者の皆様に向けて実施していた調査です。ベンダーの認知度や企業評価について調査を行っています。貴社の営業活動やマーケティング活動のご参考になる、読者の生の声が凝縮されたサーベイです。

- ・対象読者 : EDN Japan ・ EE Times Japan ・ MONOist ・ スマートジャパンのメール受信可能な方の中から、「半導体」の導入に関与されている方約2万名へ全数配信
- ・実施日 : 2024年4月中にアンケートを開始予定
- ・ご納品 : アンケート終了後から1カ月後を予定

- 日清紡マイクロデバイス（新日本無線とリコー電子デバイスが統合）
- 京都セミコンダクター
- ソニーセミコンダクタソリューションズ
- ams OSRAM
- Vishay Intertechnology
- メガチップス
- ノルディック・セミコンダクター
- MediaTek
- ラピスセミコンダクタ
- 三菱電機
- サムスン電子
- 東芝デバイス&ストレージ
- セイコーエプソン
- キオクシア
- スタンレー電気
- ベルニクス
- ミネベアミツミ
- エイブリック
- ザインエレクトロニクス
- NXPセミコンダクターズ
- STマイクロエレクトロニクス
- サンケン電気
- シーラス・ロジック
- Vicor
- ブロードコム
- アナログ・デバイセズ/マキシム
- テキサス・インスツルメンツ
- トレックス・セミコンダクター
- マイクロチップ・テクノロジー
- NVIDIA
- ソシオネクスト
- 富士電機
- クアルコム
- Silicon Laboratories
- Allegro MicroSystems
- ラティスセミコンダクター
- インフィニオン テクノロジーズ
- onsemi（オンセミ）
- ルネサス エレクトロニクス
- シャープ
- AMD/ザイリンクス
- ローム
- マイクロンメモリ ジャパン
- インテル
- 富士通セミコンダクターメモリソリューション
- Apex Microtechnology
- ヌヴォトンテクノロジー



※2023年12月現在
※対象企業は、予告なく変更となる場合がございます
※順不同敬称略

設問／選択肢例（一部、前回実績より）

■半導体製品の使用状況について、当てはまるものを製品区分ごとにチェックしてください（複数回答）。

フラッシュ内蔵MCU、マスクROM内蔵MCU、MPU、DSP、DRAM/SRAM、不揮発性RAM（FRAMなど）、ROM（EPROM/EEPROM/マスクROM）、フラッシュメモリー、汎用論理IC/インターフェースIC/ドライバIC、A-D/D-Aコンバータ/オペアンプ/コンパレータIC、オーディオ・ビデオ用IC、その他アナログIC/ミックスドシグナルIC、電源用IC（DC-DCコンバータ、マネジメントICなど）、電力用半導体（IC含む）、高周波用半導体（IC・モジュール含む）、その他個別半導体（トランジスタ・ダイオードなど）、表示器用ドライバIC/画像処理LSI、通信・ネットワーク用IC、その他特定用途向け標準IC/LSI、PLD/FPGA、ゲートアレイ/ストラクチャードASIC、フルカスタムシステムLSI、光半導体、撮像素子

■あなたは、半導体製品をどのような機器に使用しますか。当てはまるものを全て選び、チェックしてください。

AV機器（携帯用含む）、デジタルカメラ/VCR、家庭用/業務用ゲーム・アミューズメント機器、携帯電話機/携帯情報機器、コンピュータ/パソコン、コンピュータ周辺機器、通信・ネットワーク機器、白物家電、オフィス機器、ロボット、機械設備（工作機など）、電源機器、組み込みボード、自動車・運輸機械、医療機器、美容機器、産業用機器、計測機器/計装機器、自動販売機、航空・宇宙・鉄道・船舶、エネルギー（発電機）、その他、使用しない

■半導体ベンダーと取引するに当たり、どのような項目を重視しますか。

性能・機能、性能・価格比、技術開発力、品揃え、生産能力、サポート体制（ドキュメント、オンラインサポート、セミナーなど）、品質・信頼性、納期順守、ホームページ、顧客への対応、環境への対応、採用実績、長期安定供給

■以下の半導体ベンダーをどの程度ご存じですか。

企業の名前は知っている/企業名と製品をよく知っている/企業名も製品も知らない

■以下の半導体ベンダーの製品利用状況について、当てはまるものを下記の中からベンダーごとに1つだけ選んでチェックを付けてください。

現在使用中/使用していない/将来は使用してみたい/このベンダーを知らない

■以下の半導体ベンダーの評価について、当てはまるものを下記の中からいくつでも選んで、チェックを付けてください。

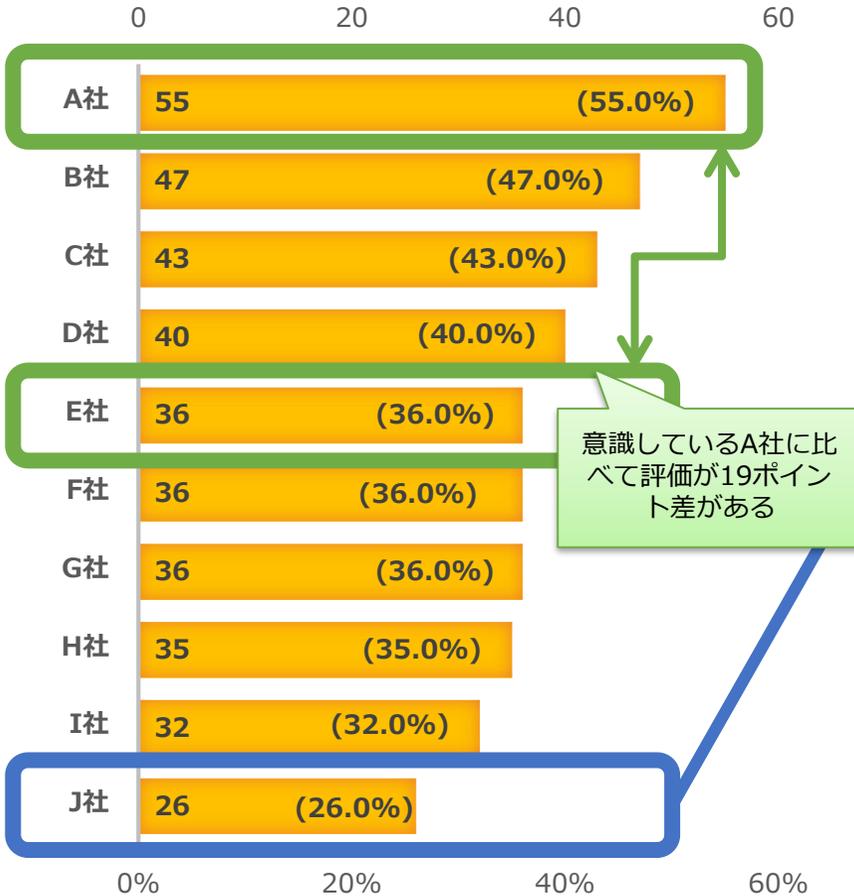
性能・機能、性能・価格比、技術開発力、品揃え、生産能力、サポート体制（ドキュメント、オンラインサポート、セミナーなど）、品質・信頼性、納期順守、ホームページ、顧客への対応、環境への対応、採用実績、長期安定供給

※アンケートの設問案は、予告なく変更となる場合がございます。

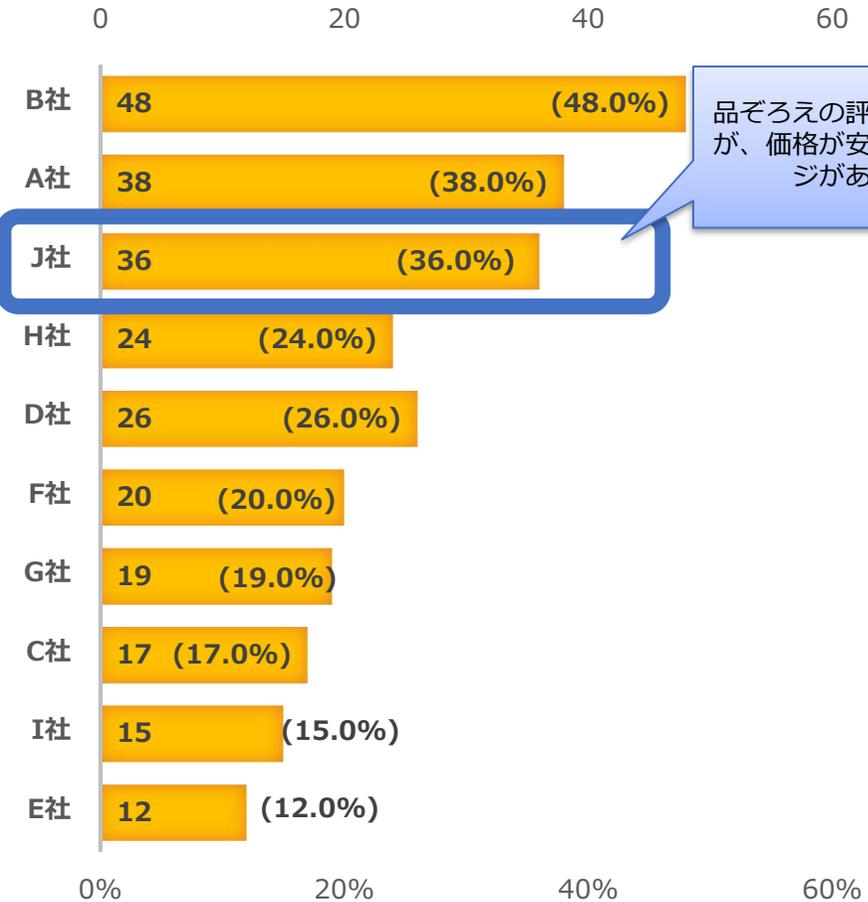
ご提供するレポートについて ※イメージ

■メーカーの評価について、当てはまるものにチェックを付けてください。（複数選択）

・品揃えが豊富



・価格が安い



貴社の認知度を客観的に知ることで、
展示会、広告などの年間プロモーションの効果を高められます。

以下のメニューのいずれかにご協賛、
または**2024年1~4月までに掲載完了**されている場合レポートをご提供いたします。

- **バナー、メール** ※合計80万円以上 (税別、クロス)
 - **タイアップ記事**
 - **リード獲得施策**
 - **Virtual EXPO 2024 春**
 - **カーボンニュートラルテクノロジーフェア 2024**
 - **Virtual EXPO 2024 秋**
- ★**新規ご出稿のお客様限定★**
30万円以上のご出稿で、レポートを提供いたします*

*新規ご出稿は、2023年1月~2024年1月に投稿がなかったお客様とさせていただきます。
 ※協賛状況によって、実施しない場合がありますので、ご了承ください。

▼スケジュール

【条件】2024年1月~2024年4月までに
 対象のプロモーションが開始・完了していること



バナー



メール



タイアップ



リードジェン

